武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“禾元生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2025）1468号文同意注册。《武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（联席主承销商）国泰海通证券股份有限公司和联席主承销商中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	1.00元		
发行股数	本次向社会公众发行8,945.1354万股，占公司发行后总股本的比例为25.02%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份		
本次发行价格	29.06元/股		
发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况	中信建投基金-共赢53号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢53号资管计划”）最终参与战略配售数量为本次公开发行数量的9.23%，即825.8774万股，认购金额为239,999,972.44元。共赢53号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。		
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创新投”）参与本次发行战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的3.00%，即268.3540万股，跟投金额为77,983,672.40元。海通创新投本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。		
是否有其他战略配售安排	是		
发行前每股收益	-0.62元（以2024年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股收益	-0.47元（以2024年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）		
发行市盈率	不适用		
发行市净率	3.43倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	2.24元（以2024年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	8.48元（以2024年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	259,945.63万元		
发行费用（不含税）	本次发行费用合计16,903.18万元，具体明细如下： 1、保荐承销费用：保荐费用100万元，承销费用14,254.83万元；保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付； 2、审计及验资费用：1,556.60万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付； 3、律师费用：471.70万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付； 4、用于本次发行的信息披露费用：427.36万元； 5、发行手续费及其他费用：92.69万元。 （注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。）		
发行人和联席主承销商			
发行人	武汉禾元生物科技股份有限公司		
联系人	李雪	联系电话	027-59403931
保荐人（主承销商）	国泰海通证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-38676888
联席主承销商	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-56051614

发行人：武汉禾元生物科技股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
2025年10月20日

证券代码：603258　证券简称：电魂网络　公告编号：2025-037

杭州电魂网络科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
119,000	119,000	2025年10月22日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次授予和预留部分的5名激励对象因离职不再具备激励资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计119,000股予以回购注销，该事项已得到2023年年度股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年8月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

2025年8月30日，公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体刊登《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-027），至今公示期已满45天，公示期间公司未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税”。鉴于本激励计划首次授予和预留部分的激励对象中有5名激励对象因离职已不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计119,000股予以回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及5人，合计拟回购注销限制性股票119,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票2,647,750股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B882377892），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2025年10月22日完成注销，公司后续将依法办理相关注册资本变更登记等手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	2,766,750	-119,000	2,647,750
无限售条件的流通股	241,248,950	0	241,248,950
股份合计	244,015,700	-119,000	243,896,700

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

浙江京衡律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次回购注销已履行现阶段必要的决策程序和信息披露，符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因及依据、人员、数量、回购注销安排符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资及股份注销手续。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司
董事会
2025年10月17日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2025-078
债券代码：113627　债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于“太平转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 回售价格：100.49元人民币/张（含当期利息）
- 回售期：2025年10月23日至2025年10月29日
- 回售资金发放日：2025年11月3日
- 回售期内“太平转债”停止转股
- “太平转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“太平转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
- 本次满足回售条款而“太平转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，本计息年度（即2025年7月15日至2026年7月14日）不能再行使回售权。
- 风险提示：投资者选择回售等同于以100.49元/张卖出持有的“太平转债”。截至2025年10月17日，“太平转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票自2025年8月27日至2025年10月15日连续三十个交易日的收盘价格低于公司“太平转债”当期转股价格的70%。根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“太平转债”的有条件回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》，就回售有关事项向全体“太平转债”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

（一）有条件回售条款

根据《募集说明书》的规定，“太平转债”有条件回售条款具体如下：

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“太平转债”第五年（2025年7月15日至2026年7月14日）的票面利率为1.80%，计息天数为100天（2025年7月15日至2025年10月22日），利息为100×1.80%×100/365≈0.49元/张，即本次回售价格为100+0.49=100.49元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“太平转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“太平转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113627”，转债简称为“太平转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期：2025年10月23日至2025年10月29日。

（四）回售价格：100.49元人民币/张（含当期利息）。

（五）回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“太平转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年11月3日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“太平转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“太平转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“太平转债”将停止交易。

四、风险提示

投资者选择回售等同于以100.49元/张卖出持有的“太平转债”。截至2025年10月17日，“太平转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

五、联系方式

联系部门：董事会办公室
电话：0574-56706588
邮箱：board@peacebird.com

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
董事会
2025年10月20日

证券代码：600460　证券简称：士兰微　编号：临2025-047

杭州士兰微电子股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年10月18日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2025年10月13日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会议应到董事15人，实到15人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、同意《关于签署〈战略合作协议〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2025-048。

本议案由公司董事会战略与投资委员会审议通过并提交。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意《关于签署〈12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2025-048。

本议案由公司董事会战略与投资委员会审议通过并提交。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2025年10月20日

证券代码：600460　证券简称：士兰微　公告编号：临2025-048

杭州士兰微电子股份有限公司关于对外投资暨签署相关协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：厦门士兰集华微电子有限公司（以下简称“项目公司”或“士兰集华”）
- 投资金额：杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司全资子公司厦门士兰微电子有限公司（以下简称“厦门士兰微”）拟与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司共同向于公司士兰集华增资51亿元并签署《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），其中本公司和厦门士兰微合计出资15亿元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易尚需提交股东会审议。《投资合作协议》自各方签字盖章后生效。各方对项目公司实缴出资，以各方均已就本次投资获得必要的内部权力机构核准、外部审批、工商登记和/或备案登记和备案为先决条件（除非各方一致同意对部分或全部条件豁免）。

- 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

士兰集华未来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的行业和市场变化、建设不达预期的风险、经营管理风险等，其未来的经营情况存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）本次交易及签署相关协议的概况

1、本次交易及签署相关协议的概况

公司本次拟投资建设的项目为“12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目（以下简称“本项目”）”。本项目定位于高端模拟芯片领域，具有技术门槛高、设计复杂、对性能、可靠性、功耗要求极严苛的特点。目前国内整体模拟芯片市场的国产化率仍然处于较低水平，尤其是高端模拟芯片的国产化仍有较大的成长空间。随着新能源汽车、大型算力服务器、工业、机器人、通讯等产业领域未来几年的快速发展，本项目的投建有利于加快高端模拟芯片的国产化替代，提高公司的国际竞争能力。

为加快完善公司在半导体产业链的布局，公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府本着平等互利、优势互补、共谋发展的原则，经友好协商于2025年10月18日在厦门市签署了《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。同时，为落实前述《战略合作协议》，公司、公司全资子厦门士兰微与厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门半导体”）、厦门新翼科技实业有限公司（以下简称“新翼科技”）于同日签署了《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。《战略合作协议》和《投资合作协议》概要如下：

（1）各方合作在厦门市海沧区合资经营项目公司“厦门士兰集华微电子有限公司（以下简称“项目公司”或“士兰集华”）”，作为“12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目”的实施主体，建设一条12英寸集成电路芯片制造生产线，产品定位为高端模拟集成电路芯片。

本项目规划总投资200亿元，规划产能4.5万片/月，分两期实施。一期项目投资100亿元（其中：资本金60.1亿元、占60.1%，银行贷款39.9亿元、占39.9%）建设主体厂房、配套库房、110KV变电站、动力站、废水站、大宗气站等公用辅助设施以及部分工艺设备购置，建成后形成月产能2万片；二期项目规划投资100亿元，在一期基础上通过购置工艺设备及配套实施，建成后新增月产能2.5万片，达产后两期将合计实现月产能4.5万片（年产54万片）。

各方通过项目实施，结合各方的优势，将项目公司建成一家符合国家集成电路产业发展规划、开展以高端模拟集成电路研发、制造和销售为主要业务的半导体公司，并具有国际化经营能力，以取得良好的经济、社会效益；同时支撑带动产业链上下游企业在厦门集聚，为中国集成电路产业发展助力。

（2）士兰集华一期项目资本金为60.10亿元，本次拟新增的注册资本为51亿元，由本公司及厦门士兰微与厦门半导体、新翼科技以货币方式共同认缴，其中：本公司和厦门士兰微合计认缴15亿元，厦门半导体认缴15亿元，新翼科技认缴21亿元。本次出资无溢价。本次增资完成后，士兰集华的注册资本将由0.10亿元增加至51.10亿元。一期项目资本金中剩余的9亿元由后续共同引进的相关其他投资方认缴出资。

二期项目规划投资100亿元，在一期项目的基础上实施（暂定其中60.1亿元为资本金投资，其余39.9亿元为银行贷款），具体方案需各方在完成相关审批流程后，另行签署投资协议等相关文件。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司（□同比例√非同比例） --增资前标的公司类型：√全资子公司□控股子公司□参股公司□未持股公司 □投资新项目 □其他：____
投资标的名称	厦门士兰集华微电子有限公司
投资金额	√已确定，具体金额（万元）：150,000 □尚未确定
出资方式	□现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：____
是否跨境	□是√否

（二）董事会审议情况以及是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于2025年10月18日召开的第九届董事会第三次会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署〈战略合作协议〉的议案》《关于签署〈12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》。

《关于签署〈12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》尚须提交公司股东会审议，董事会同时提请股东会授权董事长陈向东先生，在该投资合作协议框架下，根据项目的实际进度签署相关法律文件（包括但不限于：与协议相关方及后续引进的相关其他投资方签署补充协议、增资协议、章程等）并实施本项目相关事宜。

（三）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资标的为公司全资子公司厦门士兰集华微电子有限公司。

（二）投资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司（□同比例√非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	厦门士兰集华微电子有限公司
统一社会信用代码	√91350205MAENAF6D34 □不适用
法定代表人	陈向东
成立日期	2025/06/24
注册资本	1,000万元
实缴资本	1,000万元
注册地址	厦门市海沧区雍厝路103号601室之十八
主要办公地址	厦门市海沧区雍厝路103号601室之十八
控股股东	杭州士兰微电子股份有限公司
主营业务	芯片制造
所属行业	C39计算机、通信和其他电子设备制造业

2、增资标的士兰集华最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,000.56	-
负债总额	0	-
所有者权益总额	1,000.56	-
资产负债率(%)	0	-
科目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	0	-
净利润	0.56	-

注：士兰集华成立于2025年6月，目前尚未产生营业收入。

3、本次增资前后士兰集华股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	杭州士兰微电子股份有限公司	1,000.00	100.00	151,000	29.55
2	厦门士兰微电子有限公司（上市公司全资子公司）	-	-		
3	厦门半导体投资集团有限公司	-	-	150,000	29.35
4	厦门新翼科技实业有限公司	-	-	210,000	41.10
合计		1,000.00	100.00	511,000	100.00

4、一期项目资本金全部到位后士兰集华资本金结构

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	占比(%)
1	杭州士兰微电子股份有限公司	151,000	25.12
2	厦门士兰微电子有限公司（上市公司全资子公司）		
3	厦门半导体投资集团有限公司	150,000	24.96
4	厦门新翼科技实业有限公司	210,000	34.94
5	共同引进相关其他投资方	90,000	14.98
合计		601,000	100.00

（三）出资方式及相关情况

士兰集华本次拟新增注册资本51亿元，由本公司、厦门士兰微与厦门半导体、新翼科技以货币方式共同认缴，其中：本公司和厦门士兰微合计认缴15亿元，厦门半导体认缴15亿元，新翼科技认缴21亿元。本次出资无溢价。本次增资完成后，士兰集华的注册资本将由0.10亿元增加至51.10亿元。本次新增的资本金可分多个阶段实缴出资到位，但各方应于2027年12月底前完成全部实缴出资。

本公司和厦门士兰微的资金来源为自有资金，不属于募集资金。

（四）其他

士兰集华目前为本公司的全资子公司，其不存在公司章程或其他文件中有法律法规之外其他限制股东权利的条款，其未被列为失信被执行人。

三、共同增资方的基本情况

（一）共同增资方之一

1、共同增资方之一的基本信息

法人/组织全称	厦门士兰微电子有限公司
统一社会信用代码	√91350200MA31Q87J7J □不适用
法定代表人	郑少波
成立日期	2018/05/22
注册资本	20,000万元
实缴资本	10,000万元
注册地址	厦门市海沧区兰英路99-1号2楼
主要办公地址	厦门市海沧区兰英路99-1号2楼
控股股东	杭州士兰微电子股份有限公司
与标的公司的关系	同为本公司的全资子公司
主营业务	集成电路设计和销售

2、共同增资方之一的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	18,859.76	20,914.57
负债总额	14,403.50	21,936.02
所有者权益总额	4,456.26	-1,021.45
资产负债率(%)	76.37	104.88
科目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	35,191.25	50,773.98
净利润	-1,522.28	-1,252.60

（二）共同增资方之二

1、共同增资方之二的基本信息

法人/组织全称	厦门半导体投资集团有限公司
统一社会信用代码	√91350200MA2XUDEM91 □不适用
法定代表人	裴华
成立日期	2016/12/09
注册资本	585,648万元
实缴资本	585,648万元
注册地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景中路43号201单元
主要办公地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景中路43号201单元
实际控制人	厦门市海沧区人民政府
与标的公司的关系	无
主营业务	以自有资金从事投资活动等

（三）共同增资方之三

1、共同增资方之三的基本信息

法人/组织全称	厦门新翼科技实业有限公司
统一社会信用代码	√91350200MADM8WPK4B □不适用
法定代表人	陈晓筠
成立日期	2024/05/20
注册资本	500,000万元
实缴资本	95,898万元
注册地址	厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街56号402室-233
主要办公地址	厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街56号402室-233
实际控制人	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	无
主营业务	科技推广和应用服务、以自有资金从事投资活动等

上述增资方均未被列为失信被执行人，均不存在影响偿债能力的重大或有事项。

四、交易标的评估、定价情况

士兰集华目前注册资本为1,000万元，全部由本公司以货币方式出资。士兰集华目前处于项目前期筹备阶段，尚未产生营业收入。

经协议各方友好协商，确定本次增资方士兰微、厦门士兰微和厦门半导体、新翼科技均按照1元出资款对应1元注册资本的价格执行增资，无需针对增资行为另外进行审计、资产评估和公开挂牌交易。

五、对外投资合同的主要内容

（一）《战略合作协议》的主要内容

1、协议各方

甲方1：厦门市人民政府

甲方2：厦门市海沧区人民政府

（“甲方1”和“甲方2”合称“甲方”）

乙方：杭州士兰微电子股份有限公司

2、项目合作内容

（1）集成电路产业是厦门新一代信息技术产业的核心基础产业。为抓住中国集成电路产业发展的战略机遇期，共同打造符合国家集成电路产业发展规划、厦门集成电路产业发展规划纲要的芯片产业，各方发挥区位、政策、技术、运营、市场、资本和产业生态上的综合优势，合作在厦门市海沧区投资建设一条对标国际领先水平、以IDM模式运营、拥有完全自主知识产权的12英寸高端模拟集成电路芯片产线（以下简称“该项目”）。

（2）该项目规划总投资200亿元人民币，计划分两期建设，一期投资规模100亿元人民币，二期投资规模100亿元人民币。两期建设完成后，将在厦门市海沧区形成年产54万片的生产能力，培育一家具有国际化经营能力的半导体公司，填补我国汽车、工业、机器人、大型服务器和通讯等产业领域关键芯片的空白，同时支撑带动产业链上下游企业在厦门集聚，为厦门市在集成电路芯片领域的产业链聚集作出贡献。

3、项目推进安排

（1）乙方将向项目充分导入其在集成电路、功率半导体、MEMS传感器等特色工艺芯片生产线和先进化合物半导体器件生产线技术、市场、人才、运营等方面的优势，结合厦门政策、区位、综合环境等优势，为产业链上下游企业提供相关产品、技术支撑与服务。

（2）甲方在依法合规、符合政策要求的前提下，以最大力度为项目提供包括基础设施配套、产业及人才政策、建设服务、金融服务、员工子女教育等方面的支持，协助项目落地、验收和持续发展。

（3）各方力争一期项目于2025年四季度拿地、年底前开工建设，完成厂房建设及设备安装调试后于2027年四季度初步通线并投产，2030年达产。

（4）各方本着务实、高效、诚信的原则，积极稳妥推进各项合作事宜，共同推动项目落地。

4、其他事项

本协议为各方深化合作、围绕该项目达成战略合作的总体框架。

（二）《投资合作协议》的主要内容

1、协议各方

甲方1：厦门半导体投资集团有限公司

甲方2：厦门新翼科技实业有限公司

乙方1：杭州士兰微电子股份有限公司

乙方2：厦门士兰微电子有限公司

上列签约方单称为“一方”，合称为“各方”；甲方1、甲方2、合称为“甲方”，乙方1、乙方2合称为“乙方”，甲方、乙方并列称为“甲乙双方”。

项目公司：厦门士兰集华微电子有限公司

2、投资步骤主要内容

（1）投资前提：甲方、乙方对项目公司实缴出资，以下列条件完成为先决条件（除非各方一致同意对部分或全部条件豁免）：各方均已就本次投资获得必要的内部权力机构核准、外部审批、工商登记和/或备案登记和备案。

（2）投资方案

1）为加快推动本项目进度，乙方1已于2025年6月24日在厦门市海沧区先行设立了项目公司。项目公司目前注册资本为1,000万元，全部由乙方1以货币出资。目前项目公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元）	出资形式	持股比例
1	杭州士兰微电子股份有限公司	1,000	货币	100%
合计		1,000	--	100%

2）项目总投资额。本项目第一期总投资100亿元，含资本金60.1亿元、占60.1%，银行贷款39.9亿元、占39.9%；第二期投资100亿元，在第一期的基础上实施（暂定其中60.1亿元为资本金投资，其余39.9亿元为银行贷款）。

3）一期项目资本金构成。针对一期项目的60.1亿元资本金，由乙方（乙方2系乙方1全资子公司）对项目公司合计出资15.1亿元（占一期项目资本金约25.12%），并负责与甲方共同引进相关其他投资方出资9亿元（占一期项目资本金约14.98%）；甲方对项目公司出资合计36亿元，包括：（1）由甲方1对项目公司出资15亿元（占一期项目资本金约24.96%）；（2）由甲方2对项目公司出资21亿元（占一期项目资本金约34.94%）。上述方案可经双方协商一致后相应优化调整。

（3）出资计划

一期项目的资本金可分多个阶段实缴出资到位，但各方应于2027年12月底前完成全部实缴出资。为尽快启动项目，甲乙双方可先于拟引进的相关其他投资方进行出资，并明确甲方各主体均按照1元出资款对应1元注册资本价格执行增资，无需针对增资行为另进行审计、资产评估和公开挂牌交易。

甲方、乙方均应按项目公司的资金需求，统筹安排其各出资主体对项目公司到资总额达到相同的进度，即，甲方各出资主体对项目公司实缴到资总额/甲方各出资主体对项目公司的认缴出资总额=乙方对项目公司的实缴到资总额/乙方对项目公司的认缴出资总额。

各方应依约及时将出资款汇入项目公司开立的专用银行账户。

（4）相关手续办理

1）各方同意，每一次出资完成后由项目公司负责委托具有资质的会计师事务所对各方的出资进行验资并出具相应的验资报告，并委派人员办理相应的工商变更登记手续。

2）各方应在投资前提达成后60日内签署项目公司增资相关协议与章程。

3、关于公司治理架构的主要内容

（1）项目公司将依据《中华人民共和国公司法》以及公司章程建立公司法人治理结构，股东会为项目公司最高权力机构。

（2）董事会：项目公司设立董事会，董事会由7名董事组成（甲方提名3名，乙方提名4名），其中甲方：甲方1提名1名董事，甲方2提名2名董事。董事长为项目公司法定代表人，董事长由甲方1提名的董事担任，由董事会选举产生。乙方按第6.1条完成第一步收购后，董事长由乙方提名的董事担任。

（3）经营管理人员：项目公司设立董事会领导下的以总经理为首的经营管理团队，经营管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，由乙方提名和推荐，并经董事会聘任或解聘。

（4）监事会：项目公司设立监事会，监事会成员共6名，其中甲方提名3名监事，乙方提名2名监事，职工监事1名，监事长由乙方提名的监事担任，由监事会选举产生。

（5）股东会决策机制

项目公司下列事项的决定需经代表超过五分之四表决权的股东表决同意方为有效，但本协议其它条款有特别约定的除外：

1）修改项目公司章程；

2）对项目公司增加或者减少注册资本作出决议；

3）对项目公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

4）审议批准各股东以项目公司股权对外质押事项；

5）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

6）审议批准项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7）对项目公司发行公司债券作出决议；

8）审议项目公司重要对外投资（认定标准为对同一项目或企业累计投资金额人民币1,000万元以上的情况）；

9）对项目公司的业务范围和/或主营业务方向发生重大改变、从事主营业务以外的业务作出决议；

10）审议批准项目公司为股东或其实际控制人、股东或其实际控制人控制的其他企业提供担保，为除股东或其实际控制人、股东或其实际控制人控制的其他企业以外任意第三方提供大于100万元人民币的担保；

11）审议批准项目公司知识产权、商标、土地使用权、房产等重大资产的处置（认定标准为评估价值人民币1,000万元以上的土地、房产、股权、知识产权等资产）；

12）审议批准项目公司的上市计划，包括中介机构(券商、保荐代表、会计师事务所、律师事务所)的聘用、上市主体、上市时间、地点、价格等；

13）审议批准订立任何投机性的互换、期货或期权交易，进行委托理财、委托贷款事项；

14）审议批准项目公司的重大资产重组（认定标准为任何与项目公司相关的、评估价值超过上一年经审计的项目公司净资产30%的资产控制权发生变更的事项）；

15）审议批准单笔金额1,000万元以上或累计占项目公司最近一期经审计净资产绝对值20%以上的关联交易。

涉及前述1）至4）项的修改或决议或决定，需经各方一致同意方可通过。

除上述约定事项外，其他法律法规或项目公司章程规定的其他股东会决策事项，则需经代表超过三分之二表决权的股东表决同意。

（6）项目公司下列重要事宜需要经全体董事一致同意方可通过，但本协议其它条款有特别约定的除外：

1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2）执行股东会的决议；

3）决定项目公司的经营